

【お知らせ】

2006年5月26日

フェリカネットワークス株式会社

**フェリカネットワークス、次期モバイルFeliCa ICチップの製造、販売ライセンスを
ソニー、東芝、ルネサス テクノロジと締結
～モバイルFeliCa ワールドの拡大と進化を推進～**

フェリカネットワークス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 河内 聡一、以下フェリカネットワークス）は、ソニー株式会社、株式会社東芝、株式会社ルネサス テクノロジの3社と、次期モバイルFeliCa ICチップの製造、販売ライセンス契約を締結しました。これにより、急速に拡大するモバイルFeliCa市場からの要望に応えていく新製品の開発を推進していきます。

フェリカネットワークスが開発した「モバイルFeliCa ICチップ」を搭載した携帯電話は、1400万台以上（2006年3月末現在、当社調べ）が普及しています。その安心、安全、便利な機能は、電子マネー、クレジット、交通チケット、会員証など多くのサービスを実現させ、市場を急拡大させています。こうした順調なモバイルFeliCaの普及に伴い、より安定的に、付加価値の高い技術とサービスを提供していきたい当社と、モバイルFeliCa市場に期待する3社が、その更なる拡大と進化に関して協調し、この度のライセンス締結にいたりました。

弊社は3社との協力関係のもと、携帯電話通信事業者、モバイルFeliCa導入事業者をはじめとする、モバイルFeliCaワールドの発展を担う各社に、常に新しい技術が活用できる環境を提供していく所存です。